

半导体

半导体月度销售额提升，建议关注上游材料需求改善

上周半导体行情跑输主要指数。上周申万半导体行业指数下跌 2.84%，同期创业板指数下跌 2.57%，上证综指下跌 2.30%，深证综指下跌 2.19%，中小板指数下跌 1.97%，万得全 A 下跌 2.13%。半导体行业指数跑输主要指数。

半导体各细分板块大部分下跌。半导体细分板块中，分立器件板块上周上涨 0.1%，半导体材料板块上周下跌 2.4%，IC 设计板块上周下跌 3.5%，封测板块上周下跌 4.6%，半导体设备板块上周下跌 5.2%，半导体制造板块上周下跌 6.4%，其他板块上周下跌 5.9%。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新发布的研究报告预估 2023 年全球半导体市场规模或达到 515 亿美元，预计下滑幅度为 10.3%，随后将出现强劲的复苏现象，2024 年预测全球整体销售提速 11.8%。

尽管按照 WSTS 预测，目前半导体行业或仍处于周期下行，根据 SIA，全球 4 月半导体月度销售额连续环比回暖+0.3%，其中中国地区销售额环比+2.9%。SIA 数据显示，2023 年 4 月全球半导体行业销售额为 399.5 亿美元，同比下降 21.6%，但较上月的 398.3 亿美元环比增长 0.3%，已经是第二个月环比增长。按区域来看，4 月仅中国和日本月度销售额环比增长，中国环比回升 2.9%，日本环比回升 0.9%，而美洲、欧洲和亚太地区/其它地区月度销售额分别下滑 1.0%、0.6%及 1.1%。尽管全球半导体市场或仍处于周期性下行，但 4 月的月度销售额继续环比回升，未来有望持续回暖，我们认为随着晶圆厂销售额逐步提升，稼动率有望回暖，半导体材料需求有望逐步改善。

根据彭博社，荷兰政府计划最快于 6 月 30 日发布新的出口管制措施，将限制 ASML 对中国大陆的芯片制造设备出口。这项出口管制规定，最早可能 6 月 30 日或 7 月第一周公布，也能作为被其他欧盟成员国的蓝图。此前，ASML 曾在官网公告，受限制的浸没式 ArF 光刻机主要为 TWIN SCAN NXT:2000i 及更先进机型。目前国内大部分产线不受荷兰光刻机出口限制影响，

建议关注：

1) 半导体零部件：正帆科技（天风机械团队联合覆盖）/江丰电子/茂莱光学/新莱应材（天风机械团队覆盖）/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机（天风机械团队覆盖）/国机精工（天风机械团队覆盖）；

2) 半导体材料设备：雅克科技/沪硅产业/华峰测控（天风机械团队覆盖）/上海新阳/中微公司/精测电子（天风机械团队联合覆盖）/长川科技（天风机械团队覆盖）/鼎龙股份（天风化工团队联合覆盖）/安集科技/拓荆科技（天风机械团队联合覆盖）/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体（天风化工团队覆盖）/凯美特气/杭氧股份（天风机械团队覆盖）/和远气体/华懋科技；

3) 半导体设计：江波龙（天风计算机团队联合覆盖）/纳芯微/圣邦股份/晶晨股份/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/中颖电子/澜起科技/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/龙芯中科/海光信息（天风计算机团队覆盖）；

4) IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；

5) 代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；

6) 卫星产业链：声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通

风险提示：宏观不确定性；进出口贸易限制影响；需求不及预期。

证券研究报告

2023 年 06 月 27 日

投资评级

行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

作者

潘暕 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com

程如莹 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruiying@tfzq.com

骆奕扬 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《半导体-行业研究周报:印度 AIoT 未来发展可期，23Q1 可穿戴同比高增长》 2023-06-12
- 2 《半导体-行业研究周报:5 月国产半导体设备中标同比+47.83%，AI+催化下新一轮大周期已现》 2023-06-05
- 3 《半导体-行业研究周报:人工智能快速发展有望催生定制化 SoC 市场》 2023-05-24

内容目录

1. 每周谈-半导体月度销售额提升，建议关注上游材料需求改善.....	3
2. 上周半导体行情回顾.....	5
3. 本周重点公司公告.....	7
4. 本周半导体重点新闻.....	9

图表目录

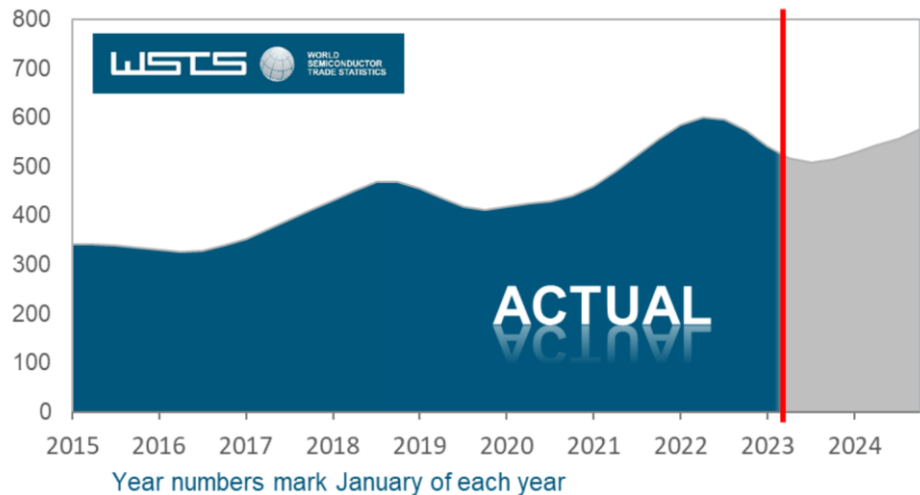
图 1：全球半导体销售额.....	3
图 2：全球半导体销售额预测（按地区）.....	3
图 3：上周 A 股各行业行情对比（%）.....	6
图 4：上周子板块涨跌幅（%）.....	6
图 5：半导体子板块估值与业绩增速预期.....	6
表 1：国内晶圆厂产能及扩产计划统计.....	4
表 2：上周半导体行情与主要指数对比.....	6
表 3：上周涨跌前 10 半导体个股.....	7

1. 每周谈-半导体月度销售额提升，建议关注上游材料需求改善

世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新发布的研究报告预估 2023 年全球半导体市场规模或达到 515 亿美元，预计下滑幅度为 10.3%，随后将出现强劲的复苏现象，2024 年预测全球整体销售提速 11.8%。

图 1：全球半导体销售额

Global semiconductor billings (billion US\$) – 12MMA



资料来源：WSTS，天风证券研究所

WSTS 下调对 2023 年半导体市场规模的预期，以应对通胀上升和终端市场需求减弱，特别是那些依赖消费者支出的市场。尽管分立器件和光电这两个主要类别预计将在 2023 年保持个位数的同比增长，分别为 5.6%和 4.6%，但其他类别预计将转向负增长，如存储市场，WSTS 预计或同比下降约 35%。

按地区来看，WSTS 预计 2023 年欧洲和日本市场或将分别增长 6.3%和 1.2%。相反，其余地区预计将面临下滑，美洲预计将下降 9.1%，亚太地区将下降 15.1%。

图 2：全球半导体销售额预测（按地区）

WSTS Forecast Summary

Spring 2023	Amounts in US\$M			Year on Year Growth in %		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Americas	141,136	128,236	150,989	16.2	-9.1	17.7
Europe	53,853	57,253	61,637	12.8	6.3	7.7
Japan	48,158	48,724	52,534	10.2	1.2	7.8
Asia Pacific	330,937	280,881	310,838	-3.5	-15.1	10.7
Total World - \$M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8
Discrete Semiconductors	33,993	35,904	38,192	12.0	5.6	6.4
Optoelectronics	43,908	45,949	45,881	1.2	4.6	-0.1
Sensors	21,782	20,410	21,575	13.7	-6.3	5.7
Integrated Circuits	474,402	412,832	470,349	2.5	-13.0	13.9
Analog	88,983	83,907	88,902	20.1	-5.7	6.0
Micro	79,073	71,470	75,855	-1.4	-9.6	6.1
Logic	176,578	173,413	185,266	14.0	-1.8	6.8
Memory	129,767	84,041	120,326	-15.6	-35.2	43.2
Total Products - \$M	574,084	515,095	575,997	3.3	-10.3	11.8

Note: Numbers in the table are rounded to whole millions of dollars, which may cause totals by region and totals by product group to differ slightly.

资料来源：WSTS，天风证券研究所

尽管按照 WSTS 预测，目前半导体行业或仍处于周期下行，根据 SIA，全球 4 月半导体月度销售额连续环比回暖+0.3%，其中中国地区销售额环比+2.9%。SIA 数据显示，2023 年 4 月全球半导体行业销售额为 399.5 亿美元，同比下降 21.6%，但较上月的 398.3 亿美元环比增长 0.3%，已经是第二个月环比增长。按区域来看，4 月仅中国和日本月度销售额环比增长，中国环比回升 2.9%，日本环比回升 0.9%，而美洲、欧洲和亚太地区/其它地区月度销售

额分别下滑 1.0%、0.6%及 1.1%。尽管全球半导体市场或仍处于周期性下行，但 4 月的月度销售额继续环比回升，未来有望持续回暖，我们认为随着晶圆厂销售额逐步提升，稼动率有望回暖，半导体材料需求有望逐步改善。

根据彭博社，荷兰政府计划最快于 6 月 30 日发布新的出口管制措施，将限制 ASML 对中国大陆的芯片制造设备出口。这项出口管制规定，最早可能 6 月 30 日或 7 月第一周公布，也能作为被其他欧盟成员国的蓝图。此前，ASML 曾在官网公告，受限制的浸没式 ArF 光刻机主要为 TWIN SCAN NXT:2000i 及更先进机型。目前国内大部分产线不受荷兰光刻机出口限制影响，根据经济观察报的报道，目前全国各地建设的半导体厂约有数百家，除了头部的半导体厂，真正能用上浸润式 DUV 的工厂并不多，整体的建设处于尚未形成规模效益的初期阶段，月产能达到数十万片晶圆的产线是非常少的。同时，这些产线不涉及先进芯片，主要用于生产技术相对成熟的芯片，如功率器件等。

表 1：国内晶圆厂产能及扩产计划统计

状态	厂商	工厂代码	地点	晶圆尺寸	当前产能(万片/月)	规划产能(万片/月)
建成	中芯国际	S1(FAB1、2、3)	上海	8 英寸	11.5	13.5
建成	中芯国际	SN1	上海	12 英寸	1.5	3.5
在建	中芯国际	SN2	上海	12 英寸	0	3.5
建成	中芯国际	B1(Fab4、6)	北京	12 英寸	5.2	6
建成	中芯国际	B2	北京	12 英寸	6.2	10
在建	中芯国际	B3P1	北京	12 英寸	0	5
计划	中芯国际	B3P2	北京	12 英寸	0	5
计划	中芯国际	B3P3	北京	12 英寸	0	5
计划	中芯国际	B3P4	北京	12 英寸	0	5
建成	中芯国际	Fab15	深圳	8 英寸	4.4	7
建成	中芯国际	Fab16A/B	深圳	12 英寸	0	4
建成	中芯国际	Fab7P2	天津	8 英寸	9.5	18
建成	中芯绍兴		绍兴	8 英寸	4.25	10
建成	中芯宁波	N1	宁波	8 英寸	1.5	1.5
建成	中芯宁波	N2	宁波	8 英寸	0	2.75
建成	华虹集团(华虹半导体)	Fab1-3	上海	8 英寸	17.8	18
建成	华虹集团(上海华力)	F5	上海	12 英寸	3.5	3.5
建成	华虹集团(上海华力)	F6	上海	12 英寸	3	4
建成	华虹集团(华虹半导体)	Fab7	无锡	12 英寸	2.5	8
计划	华虹集团(上海华力)	Fab8	上海	12 英寸	0	4
计划	华虹集团(华虹半导体)	Fab9	无锡	12 英寸	0	8
建成	长江存储	Fab1	武汉	12 英寸	5	10
在建	长江存储	Fab2	武汉	12 英寸	0	10
建成	长江存储	Fab3	武汉	12 英寸	0	10
建成	武汉新芯	Fab1	武汉	12 英寸	2.5	2.5
建成	武汉新芯	Fab2	武汉	12 英寸	2.5	11.5
在建	紫光集团	CD	成都	12 英寸	0	30
建成	合肥长鑫	Fab 1	合肥	12 英寸	4	12.5
计划	合肥长鑫	Fab2	合肥	12 英寸	0	12.5
计划	合肥长鑫	Fab3	合肥	12 英寸	0	12.5

建成	晶合集成	N1	合肥	12 英寸	4	4
建成	晶合集成	N2	合肥	12 英寸	0	4
计划	晶合集成	N3	合肥	12 英寸	0	4
计划	晶合集成	N4	合肥	12 英寸	0	4
在建	广州粤芯		广州	12 英寸	2	4
在建	芯恩		青岛	12 英寸	0.3	4
在建	芯恩		青岛	8 英寸	3	8
建成	燕东微电子		北京	8 英寸	3	5
在建	华润微电子		重庆	12 英寸		
建成	华润上华		无锡	8 英寸	6	
在建	士兰微(士兰集昕)	Fab2	杭州	8 英寸	3.6	4
建成	士兰微(士兰集昕)	Fab1	杭州	8 英寸	3.5	4
建成	士兰微(士兰集科)	Fab1	厦门	12 英寸	4	8
计划	士兰微(士兰集科)	Fab2	厦门	12 英寸		8
建成	上海新进芯		上海	8 英寸	1.5	
在建	积塔半导体		上海	12 英寸	5	
在建	积塔半导体		上海	8 英寸	6	
建成	上海先进		上海	8 英寸	2.3	
建成	台积电	NJFab16	南京	12 英寸	2	2
建成	联电-厦门联芯	Fab 12x	厦门	12 英寸	2	5
建成	联电-和舰科技		苏州	8 英寸	10	
在建	赛莱克斯		北京	8 英寸	0.5	3
计划	中科晶芯		成都	8 英寸	未定	
建成	中航(重庆)微电子		重庆	8 英寸	3	
计划	矽力杰		青岛	12 英寸	4	
在建	万国半导体	CQ	重庆	12 英寸	5	7
建成	华微电子		吉林	8 英寸	0.5	2
在建	海辰半导体		无锡	8 英寸	1	10.5
建成	广义微电子		四川	6 英寸	15	15
暂停	格罗方德	FAB11-1	成都	12 英寸	2	
暂停	格罗方德	FAB11-2	成都	12 英寸	6.5	
建成	TI(成都)		成都	8 英寸	5	
建成	三星	FABx1	西安	12 英寸	12	12
建成	三星	FABx2	西安		8	20
建成	英特尔	Fab68 二期	大连	12 英寸	4	4
建成	SK 海力士	HC1	无锡	12 英寸	10	10
建成	SK 海力士	HC2	无锡	12 英寸	10	20
建成	时代芯存		淮安	12 英寸	N/A	0.83
暂停	紫光集团		南京	12 英寸	0	30
暂停	武汉弘芯		武汉	12 英寸	0	4.5
建成	福建晋华	F1-F2	泉州	12 英寸		6
建成	英锐半导体			6 英寸	2.5	5
建成	芯睿电子			6 英寸	2	2

资料来源：新材料在线公众号，天风证券研究所

2. 上周半导体行情回顾

上周半导体行情跑输主要指数。上周申万半导体行业指数下跌 2.84%，同期创业板指数下

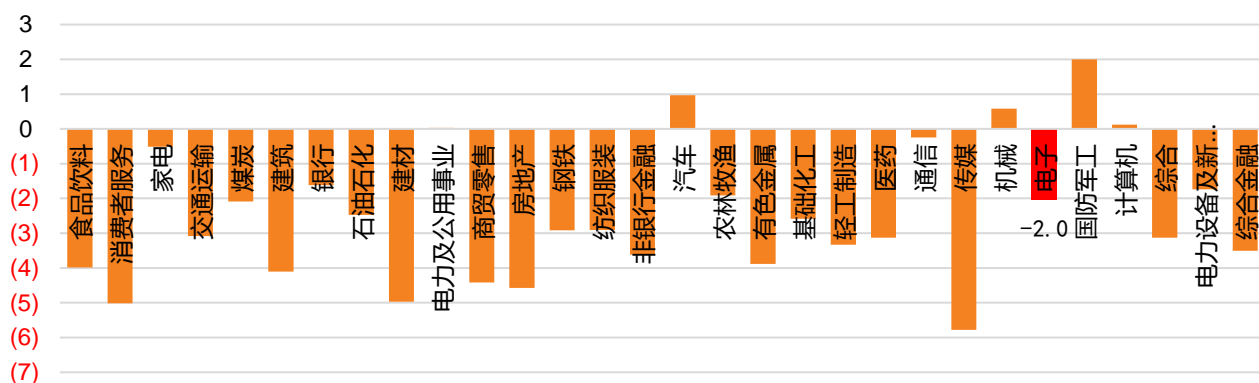
跌 2.57%，上证综指下跌 2.30%，深证综指下跌 2.19%，中小板指数下跌 1.97%，万得全 A 下跌 2.13%。半导体行业指数跑输主要指数。

表 2：上周半导体行情与主要指数对比

	上周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	-2.57	-0.28
上证综合指数	-2.30	-0.54
深证综合指数	-2.19	-0.65
中小板指数	-1.97	-0.88
万得全 A	-2.13	-0.71
半导体（申万）	-2.84	-

资料来源：Wind，天风证券研究所

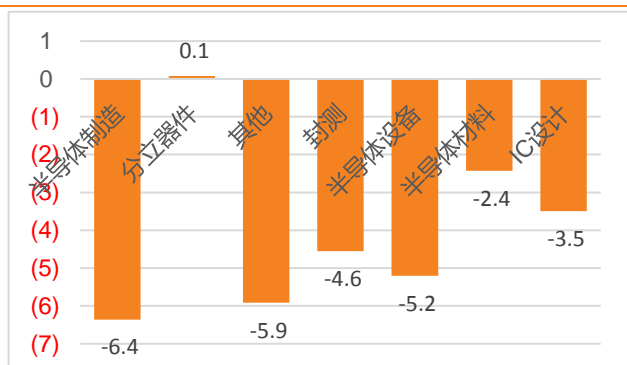
图 3：上周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

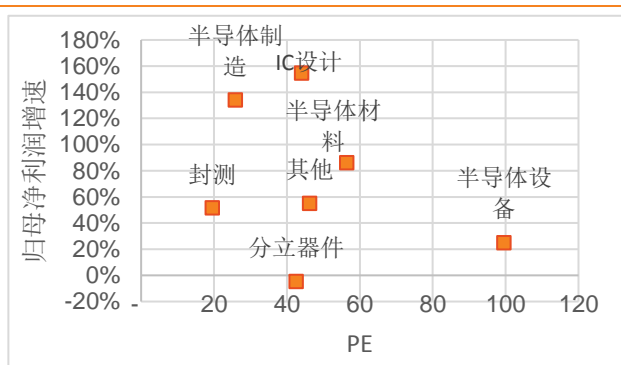
半导体各细分板块大部分下跌。半导体细分板块中，分立器件板块上周上涨 0.1%，半导体材料板块上周下跌 2.4%，IC 设计板块上周下跌 3.5%，封测板块上周下跌 4.6%，半导体设备板块上周下跌 5.2%，半导体制造板块上周下跌 6.4%，其他板块上周下跌 5.9%。

图 4：上周子板块涨跌幅 (%)



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 5：半导体子板块估值与业绩增速预期



资料来源：Wind，天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为：北斗星通、鸿远电子、苏州固锟、必创科技、火炬电子、振华科技、中环装备、阿石创、TCL 中环、敏芯股份。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为：和林微纳、深科技、长川科技、长光华芯、富瀚微、中芯国际、睿能科技、容大感光、润欣科技、北京君正。

表 3：上周涨跌前 10 半导体个股

股票名称	涨跌幅	股票名称	涨跌幅
北斗星通	16%	和林微纳	-18%
鸿远电子	14%	深科技	-12%
苏州固锴	11%	长川科技	-11%
必创科技	11%	长光华芯	-10%
火炬电子	8%	富瀚微	-9%
振华科技	6%	中芯国际	-9%
中环装备	5%	睿能科技	-9%
阿石创	5%	容大感光	-8%
TCL 中环	2%	润欣科技	-8%
敏芯股份	2%	北京君正	-7%

资料来源：Wind，天风证券研究所

3. 本周重点公司公告

【力合微 688589.SH】

公司于 2023 年 06 月 26 日发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》。公告称，本次拟发行可转债总额为人民币 38,000.00 万元，发行数量 380,000 手。发行募集资金将用于智慧光伏及电池智慧管理 PLC 芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备 PLC 芯片研发及产业化项目和科技储备资金项目。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

【中晶科技 003026.SZ】

公司于 2023 年 06 月 22 日发布《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。公告称，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过权益分派事宜，以截至 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 101,017,880 股，扣除即将回购并注销的用于股权激励的限制性股票后的总股本 100,633,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金 20,126,703.20 元（含税）；送红股 0 股（含税）；不以资本公积金转增股本。分派对象为截止 2023 年 6 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

【国芯科技 688262.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《苏州国芯科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。公告称，公司于 2023 年 5 月 18 日的 2022 年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,000,000.00 元（含税），2022 年度公司现金分红金额（含税）占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 78.01%。分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。

【晶丰明源 688368.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《上海晶丰明源半导体股份有限公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。公告称，公司已完成对 2022 年第二期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。截止 2023 年 6 月 7 日，公司已收到 57 名限制性股票激励对象缴纳的限制性股票认购款合计人民币 666,400.00 元，其中新增注册资本（股本）人民币 33,320.00 元整，资本公积（股本溢价）633,080.00 元。本次归属的限制性股票数量为 33,320 股，占归属前公司总股本的比例约为 0.05%，不会对公司最近一期财务状况及经营成果构成重大影响。

【气派科技 688216.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《气派科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》。公告称，发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，经公司 2022 年年度股东大会授权的董事会决定启动发行程序，并在中国证监会作出予以注册决定后 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且募集资金总额不超过 13,000.00 万元（含本数），同时不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行股票募集资金总额在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于第三代半导体及硅功率器件先进封测项目和偿还银行贷款。

【银河微电 688689.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《常州银河世纪微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。公告称，公司于 2023 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 6 月 20 日为授予日，以 15.00 元/股的授予价格向 6 名激励对象授予 85.00 万股限制性股票。公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留住公司管理人员、核心技术人员以及其他人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展。

【晶合集成 688249.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《合肥晶合集成电路股份有限公司关于新产品研发进展的自愿性披露公告》。公告称，目前公司已顺利完成 55nmTDDI 产品开发，且实现大规模量产。目前该产品产能达到满载状态，且已成功进入 LCD 面板及智能手机市场。为满足客户需求，公司预计将于本年度持续提升 55nm 产能。同时，40nm 高压 OLED 平台开发取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产品设计及流片的能力，预计本年度将建置产能以满足客户需要。公司紧抓机遇，持续拓展显示驱动芯片工艺平台，向高阶制程发展，产品应用逐渐覆盖 LCD、LED、AMOLED 等领域，以提升公司的核心竞争力，促进公司经营持续、健康、稳定发展，并助力本土产业加速升级。

【纳芯微 688052.SH】

公司于 2023 年 06 月 21 日发布《苏州纳芯微电子股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》。公告称，因自身资金需求，公司股东国润瑞祺拟在本减持计划披露的减持期间内，累计减持不超过 4,244,688 股，即不超过公司总股本的 3.00%，其中通过大宗交易方式减持不超过 3,537,240 股，减持股份占公司总股本的比例不超过 2.50%；通过竞价交易方式减持不超过 707,448 股，减持股份占公司总股本的比例不超过 0.50%。

【佰维存储 688525.SH】

公司于 2023 年 06 月 20 日发布《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》。公告称，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为 399 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，锁定期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 1,791,495 股，占公司股本总数的 0.4163%。本次上市流通日期为 2023 年 06 月 30 日，上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。

【长光华芯 688048.SH】

公司于 2023 年 06 月 20 日发布《苏州长光华芯光电技术股份有限公司关于股东减持计划的公告》。公告称，公司于近日收到国投创业宁波基金出具的《关于股份减持计划的告知函》，因股东自身经营需要，国投创业宁波基金计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减持数量不超过 3,253,923 股（占上市公司总股本比例不超过 1.85%）。本次减持以大宗交易方式减持股份，减持期间为自上市公司公告披露之日起三个交易日后的三个月内。

4. 本周半导体重点新闻

CSTIC 2023 中国国际半导体技术大会隆重开幕。6 月 26 日，由 SEMI 和 IEEE-EDS 联合举办的中国国际半导体技术大会（CSTIC）今天在上海国际会议中心隆重开启。本届大会所有的 Oral & Poster speakers 来自 105 家不同的公司和机构，其中 61%来自于产业界，39%来自学术界，彰显了国际合作的力量以及产业、学术合作的重要性。SEMI 全球副总裁、中国区总裁居龙表示目前半导体行业处于关键发展期，面临着来自下行衰退周期和地缘政治影响的两方面挑战；并预测 2023 年全球半导体销售额将下行约 10%，2024 年初开始复苏，长期来看，预估到 2030 年，全球半导体市场规模有望达到一万亿美元。

罗姆与纬湃科技签署 SiC 功率元器件长期供货合作协议。2023 年 6 月 26 日，据“罗姆半导体集团”微信公众号消息，近日，SiC（碳化硅）功率元器件领域的先进企业 ROHM Co., Ltd.（罗姆）与全球先进驱动技术和电动化解决方案大型制造商纬湃科技（Vitesco）签署了 SiC 功率元器件的长期供货合作协议。根据该合作协议，双方在 2024 年至 2030 年间的交易额将超过 1300 亿日元。此次合作将使 Vitesco 能够确保对电动汽车开发具有战略意义且非常重要的 SiC 芯片的产能。今后双方将继续深化合作，通过 SiC 助力电动汽车进一步提高效率并实现更快的充电速度。

美光宣布在印度建造封测工厂，投资总额高达 27.5 亿美元。2023 年 6 月 26 日，据 IT 之家 6 月 22 日消息，美光科技公司今天宣布计划在印度古吉拉特邦建造一座新的组装和测试工厂，新工厂将实现 DRAM 和 NAND 产品的组装和测试制造。美光表示，古吉拉特邦的新组装和测试工厂预计将于 2023 年开始分阶段建设。第一阶段将于 2024 年底开始投入运营，第二阶段将在本世纪下半叶开始。美光在该项目的两个阶段的投资将高达 8.25 亿美元，并将获得印度中央政府提供的项目总成本 50%的财政支持，以及古吉拉特邦提供的项目总成本 20%的激励措施。美光科技和印度政府在这两个阶段的投资总额将高达 27.5 亿美元。

Stellantis 与鸿海成立合资公司，进军车用半导体领域。2023 年 6 月 20 日，据外媒，Stellantis 集团与鸿海科技集团共同宣布，双方将以 50:50 比例组建合资公司 SiliconAuto。预计自 2026 年起，该合资公司将向包括 Stellantis 集团在内的汽车行业客户提供一系列最先进的车用半导体设计与销售服务。据悉，SiliconAuto 公司总部将设在荷兰，由 Stellantis 与鸿海双方共同组建经营团队。Stellantis 将向 SiliconAuto 输入未来电动车及各类新能源车平台性能交付所需的相关技术。本次合资公司的成立是继 Stellantis 集团和鸿海集团于 2021 年 12 月双方签署在车用半导体领域建立合作关系谅解备忘录后的一大进展。此外，双方还有合资公司项目 Mobile Drive，该合资公司主要开发能提供消费电子功能、人机交互界面和服务的智

能座舱。

英特尔将投资超 330 亿美元在德国建两座芯片制造厂。2023 年 6 月 20 日，据外媒报道，当地时间 6 月 19 日，英特尔宣布斥资超 300 亿欧元在德国马格德堡建设两家芯片工厂，并预计第一家工厂将在欧盟委员会批准方案后的四到五年内投入生产。这将为整个行业将创造数万个工作岗位。德国总理奥拉夫·舒尔茨在声明中称，这是德国历史上最大的一笔外国直接投资。日前，该公司宣布投资 46 亿美元和 250 亿美元，分别在波兰及以色列建设新厂。此次在德国投资建厂，是英特尔四天内宣布的第三笔大额投资。英特尔 CEO 帕特·基尔辛格承诺，将斥资逾 800 亿美元在全球各地建设新工厂，以期在技术方面赶上强大的竞争对手。

天府新区集成电路设计创新公共平台·四川天府集成电路产业创新联盟正式成立。2023 年 6 月 19 日，天府新区集成电路设计创新公共平台（天府 ICC）发布活动暨四川天府集成电路产业创新联盟发布仪式成功举行。省市发展改革委、经济和信息化、科技等部门，四川天府新区党工委管委会、电子科技大学有关领导，集成电路相关研究机构、重点企业等 50 余家单位代表参与活动。天府新区集成电路设计创新公共平台是为贯彻落实省、市、新区加快发展数字经济的战略部署，助力集成电路产业“建圈强链”，在国家发改委及省市大力支持下，由成都天投集团投资 1.1 亿元建设而成。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com